

檔 號：
保存年限：

明新學校財團法人明新科技大學 函

地址：30401新竹縣新豐鄉新興路1號
聯絡人：孫郁婷
電子信箱：must9527@must.edu.tw
聯絡電話：03-5593142#3284
傳真電話：(03)5595142

受文者：臺北市立大學

發文日期：中華民國108年5月1日

發文字號：明新（工）字第1080004230號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：AI+半導體封測技術交流會-活動簡章 (1081200347_1_ATTCH1.pdf)

主旨：本校舉辦「AI+半導體封裝測試人才培育及技術交流會」，活動簡章如附件一，敬邀貴校蒞臨指導並鼓勵所屬成員踴躍參加，也請協助公告且轉知相關人員踴躍報名參加，請查照。

說明：

台灣的封測公司正在進行新一波的智慧封裝測試產業革命，以「智慧製造」技術為核心，結合「智慧感測系統」和「智慧資料分析」，研發相關的封裝測試設備與環境。維持生產線運作之核心除了技術、製程與品質之外，背後資訊系統之運作及生產管理手法之應用，也是提升競爭力的重要關鍵因素，因此也與「精實生產管理」及「大數據分析」緊密連結，甚至導入「人工智慧」技術，藉由深度學習提高製程的良率。

本技術交流會邀請半導體封裝測試產業相關的產官學研專家學者相聚，藉由專題演講、公開討論進行「人工智慧」與「半導體封裝測試」技術交流，並討論如何進行人才之培育。

一、活動時間：108年5月15日(星期三)上午09時00分至下午17時00分。

市立大學 1080503



VWAA1086011785

二、活動地點：明新科技大學 鴻超樓B1多功能講堂（新竹縣新豐鄉新興路1號）。

三、報名對象：半導體封裝測試業界先進；大專、高中職學校師生或對AI+半導體有興趣者等，且全程參與者，給予7小時研習證書。

四、報名期限：即日起至108年5月13日(星期一)止。

五、報名方式：線上報名，名額約80名，報名網址為：
<https://goo.gl/forms/d56gx3PkphMYE8zH3>。

六、聯絡資訊：曾小姐vivien@must.edu.tw；孫小姐
must9527@must.edu.tw；電話：03-5593142#3285。若有
任何疑問，歡迎與我們聯繫。

正本：各公私立大專校院、各公私立高級中學、各公私立高級職業學校、矽格股份有限公司、神通資訊科技股份有限公司、科技部、新竹縣政府、經濟部工業局工業區組、經濟部工業局、力成科技股份有限公司、均豪精密工業股份有限公司

副本：本校工學院

